	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W2XP010D</b>	文件编号	临时
	<b>高频放大环境额定双极型晶体管</b>	版本号	18-B1-06
		页码	1/2

## 1 主要用途及主要特点

### 1.1 主要用途

用 W2XP010D 芯片封装的成品管主要用于低压电源调整电路及一般高频放大电路。

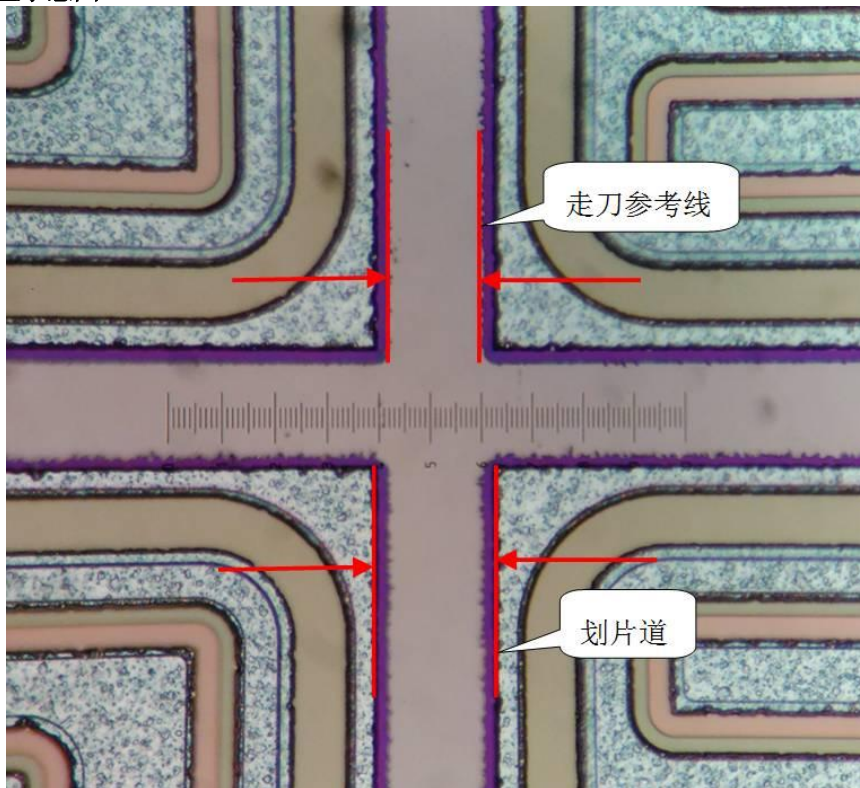
### 1.2 主要特点

- 击穿电压高
- 饱和电压较低

## 2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	1.38×1.38	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	250±20	
	划片道*尺寸 (μm)	50	
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	基区	145×310
		发射区	132×380
	钝化层		Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	4.0±0.6
	背面电极	金属	银
	硅片直径 (mm)		φ125
	装片要求(推荐)		锡铅烧结
	键合要求(推荐)		铜丝; φ42μm; E、B区各一根

### \* 划片道位置示意图:




备注: 划片道**两侧**的铝条不断裂即判为合格。

## 江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号  
电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>  
传真: (0510) 86851532

	<b>江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片</b> <b>W2XP010D</b>	文件编号	临时
	<b>高频放大环境额定双极型晶体管</b>	版本号	18-B1-06
		页 码	2/2

### 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

#### 3.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基 极电压	$V_{CB0}$	-30	V	推荐封装形式: TO-251 推荐成品型号: 2SB1412
集电极-发射极电压	$V_{CE0}$	-20	V	
发射极-基 极电压	$V_{EB0}$	-6	V	
集电极电流	$I_C$	-5	A	
耗散功率( $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )	$P_{tot}$	1	W	
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

#### 3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=-25\text{V}, I_E=0$			-0.5	$\mu\text{A}$
发射极-基极截止电流	$I_{EB0}$	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$			-0.5	$\mu\text{A}$
共发射极正向电流传输比的静态值	$h_{FE}$	$V_{CE}=-2\text{V}, I_C=-0.5\text{A}$	82		390	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CEsat}$	$I_C=-4\text{A}, I_B=-100\text{mA}$			-1	V
特征频率	$f_T$	$V_E=-6\text{V}, I_C=-50\text{mA}$ $f=30\text{MHz}$	50			MHz

#### 3.3 典型特性曲线

暂无

注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ , 湿度  $\leq 45\%$ ;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号  
电 话: (0510) 86851182

网 址: <http://www.xs-elec.com>  
传 真: (0510) 86851532